JP2001040021A Page 1 of 1

Original document

RADIATION CURING PASTE COMPOSITION FOR BAKING AND STRUCTURE USING THE SAME

Publication JP2001040021 (A)

number:

Publication date: 2001-02-13

Inventor(s): KATO ISAO; ARAI JUNICHI \pm Applicant(s): TOPPAN PRINTING CO LTD \pm

Classification:

- international: C08F2/46; H01G4/12; H05K1/03; C08F2/46; H01G4/12; H05K1/03; (IPC1-

7): C08F2/46; H01G4/12; H05K1/03

- European:

Application JP19990217067 19990730

number:

Priority number JP19990217067 19990730

(s):

View INPADOC patent family View list of citing documents

Abstract of JP 2001040021 (A)

Translate this text

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a radiation-curing paste composition for baking capable of increasing the aspect ratio of a pattern to be formed and shortening the pattern-forming process and provide a structure using the same in a method for forming inorganic structures such as insulators, dielectrics and the likes by printing or transcription. SOLUTION: This radiation-curing paste composition comprises (A) an inorganic powder containing a black pigment which reduces permeability in the ultraviolet region by baking at >=400 deg.C, (B) a photopolymerization initiator and (C) a radiation-curing monomer containing an acryloyl group of >=2 functionality and has a saturated chain hydrocarbon structure having >=4C atoms as a main ingredient. Instead of the ingredient (C), (D) a radiation-curing monomer containing an acryloyl group of >=1 functionality and has >=4C saturated chain hydrocarbon structure and (E) a radiation-curing monomer containing an acryloyl group having >=2 functionality can be used.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特測2001-40021 (P2001-40021A)

(43)公開日 平成13年2月13日(2001.2.13)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C08F	2/46		C 0 8 F 2/46	4 J 0 1 1
H01G	4/12		H 0 5 K 1/03	610H 5E001
∥ H05K	1/03	6 1 0	H 0 1 G 4/12	

審査請求 未請求 請求項の数4 〇L (全 6 頁)

(21)出顧番号 特願平11-217067 (71)出願人 000003193

凸版印刷株式会社 (22) 出願日 平成11年7月30日(1999.7.30) 東京都台東区台東1丁目5番1号

(72)発明者 加藤 功

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印

刷式会社内

(72)発明者 新井 潤一

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印

刷式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 焼成用放射線硬化ペースト組成物およびそれを用いた構造体

(57)【要約】

【課題】印刷や転写法による絶縁体、誘電体などの無機 構造体の形成方法において、形成するパターンのアスペ クト比の向上、およびパターン形成工程の短縮が可能と なる焼成用放射線硬化ペースト組成物とそれを用いた構 造体の提供。

【解決手段】(A)400℃以上の焼成により紫外域に おける透過率が減少する黒色顔料を含む無機粉末、

- (B) 光重合開始剤および(C) 2官能以上のアクリロ イル基を含有し、炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造 を含有する放射線硬化モノマーを主成分とする焼成用放 射線硬化ペースト組成物としたものである。また、
- (C)の代わりに(D)1官能以上のアクリロイル基を 含有し炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含有する 放射線硬化モノマーおよび(E)2官能以上のアクリロ イル基を含有する放射線硬化モノマーを用いてもよい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)400℃以上の焼成により紫外域に おける透過率が減少する黒色顔料を含む無機粉末、

(B)光重合開始剤および(C)2官能以上のアクリロイル基を含有し、炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含有する放射線硬化モノマーを主成分とする焼成用放射線硬化ペースト組成物。

【請求項2】(A)400℃以上の焼成により紫外域における透過率が減少する黒色顔料を含む無機粉末、

(B)光重合開始剤、(D)1官能以上のアクリロイル基を含有し炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含有する放射線硬化モノマーおよび(E)2官能以上のアクリロイル基を含有する放射線硬化モノマーを主成分とする焼成用放射線硬化ペースト組成物。

【請求項3】請求項1または2記載の焼成用放射線硬化ペースト組成物をパターン形成した後、放射線により露光硬化させ、その硬化物を焼成することで形成される構造体。

【請求項4】請求項1または2記載の焼成用放射線硬化ペースト組成物を被転写体上に転写し、放射線により露光硬化させ、その硬化物を焼成することで形成される構造体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、焼成により無機構造体を形成するための焼成用放射線硬化ペースト組成物に関するものである。さらに詳しくは、電子機器などの回路基板、各種ディスプレイなどの製造において、厚膜形成技術を活用した絶縁体、誘電体などの無機構造体の形成に利用される。

[0002]

【従来の技術】従来より、絶縁体、誘電体等の無機厚膜 形成方法としてスクリーン印刷等の印刷塗工技術、転写 技術などがある。最終形成材料である無機物およびパタ ーン成形性を付与する有機物からなるペーストを印刷お よび転写などによりパターンを基板に形成し、さらに焼 成することにより、無機焼成パターンを得ている。

【0003】このような無機焼成パターン形成用ペーストとして、溶剤型の非放射線硬化焼成ペーストや同じく溶剤型の放射線硬化焼成ペーストがある。これらは、無機焼成パターンを形成する過程において熱乾燥、冷却の工程を必要とするため、タクトタイムが大幅にかかっている。

【0004】このような問題点を解決するため、無溶剤型の放射線硬化焼成ペーストが特開昭54-13591号公報の実施例1に開示されている。しかしながら、無溶剤型放射線硬化焼成ペーストでは、溶剤を用いていないため、構造体の成形性を高めるためには、有機物が溶剤型と比較して多く含まれている。このため、焼成時に割れ、剥がれが発生するという問題点があった。

【0005】また、溶剤型焼成用放射線硬化ペースト組成物であっても、溶剤量を最小限にすることによって、 上述した熱乾燥、冷却の工程を行うことなく、光硬化を はじめとする放射線硬化により成形が可能である。

【0006】ただし、放射線硬化ペースト組成物が放射線を吸収してしまう場合には、露光深度が十分に得られず、硬化が不十分となり高精細のパターンが得られないという問題点があった。そのため、厚膜パターンを得るためには、ペースト塗布、露光を何回も繰り替えすなどの方法をとる必要があった。特に、紫外光にて硬化を行い、透過率が低い黒色である場合は露光深度が浅くなり、硬化が不十分となる傾向が強かった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような問題点を解決するためになされたものであり、その課題とするところは、熱乾燥、冷却工程が不要であり、かつ露光深度を向上させる焼成用放射線硬化ペースト組成物とこれを用いて形成した構造体、およびこれを焼成することにより、焼成前に比べて透過率が減少する構造体を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の発明は、(A)400℃以上の焼成により紫外域における透過率が減少する黒色顔料を含む無機粉末、(B)光重合開始剤および(C)2官能以上のアクリロイル基を含有し、炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含有する放射線硬化モノマーを主成分とする焼成用放射線硬化ペースト組成物である。

【0009】本発明の第2の発明は、(A) 400℃以上の焼成により紫外域における透過率が減少する黒色顔料を含む無機粉末、(B) 光重合開始剤、(D) 1官能以上のアクリロイル基を含有し炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含有する放射線硬化モノマーおよび

(E) 2官能以上のアクリロイル基を含有する放射線硬化モノマーを主成分とする焼成用放射線硬化ペースト組成物である。

【 0 0 1 0 】本発明の第3の発明は、請求項1または2 記載の焼成用放射線硬化ペースト組成物をパターン形成 した後、放射線により露光硬化させ、その硬化物を焼成 することで形成される構造体である。

【 0 0 1 1 】本発明の第4の発明は、請求項1または2 記載の焼成用放射線硬化ペースト組成物を被転写体上に 転写し、放射線により露光硬化させ、その硬化物を焼成 することで形成される構造体である。

[0012]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態につき説明する。

【0013】本発明における組成比は、おおよそ次の通りである。

(A)無機粉末

(B) 光重合開始剤

70~92重量部 0.1~1重量部 5~24重量部

(C)、(D)および(E)放射線硬化モノマー その他(溶剤、添加剤など)

2~5重量部

以上の組成について順を追って説明する。

【0014】本発明における(A)無機粉末は、ガラスフリット、骨材(フィラー)および黒色顔料から構成される。ガラスフリットは、焼成温度の低温化のため、低融点である $PbO-B_2O_3-SiO_2$ 系、 $PbO-ZnO-B_2O_3$ 系、 $PbO-ZnO-B_2O_3-SiO_2$ 、 $ZnO-B_2O_3$ -SiO_2系などを用いることが好ましいが、これに限るものではない。フィラーとしては、アルミナ、ジルコニア、チタニア、ムライト、マグネシアなどの無機酸化物や目的とする焼成温度では軟化しない前述のガラスフリットよりも高融点であるガラスフリットもフィラーとして用いることができる。さらに、黒色顔料もフィラーとして機能させることも可能である。

【0015】黒色顔料としては、Cr、Fe、Co、Mn、Cu、Ni等の酸化物があげられる。本発明では、焼成前後で透過率を変化させるため、焼成による(温度上昇による)酸化物のイオン価の変化(酸化、還元反応)に起因する色の変化を利用する。例えば、コバルトでは緑褐色のCo0を焼成した場合にできる Co_3O_4 は黒色である。同様に、銅では赤色の Cu_2 0は、黒色のCu0になり、鉄では赤褐色の Fe_2O_3 は、黒色のFe0になる。また、ニッケルでは緑黒色のNi0は、黒色の Ni_2O_3 になる。これらの色の変化、および最高焼成温度を勘案して、添加する材料の組み合わせを決定する。なお、上記の黒色顔料を 2種類以上添加することが好ましい。

【0016】本発明に用いる(B)光重合開始剤としては、アセトフェノン、2,2'ージトキシアセトフェノン、ベンジルジメチルケタール、ベンゾフェノン、ローベンゾイル安息香酸メチル、ベンゾインーnーブチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、2ーヒドロキシー2ーメチループロピオフェノン、2ーメチルチオキサントン、2ークロロチオキサントン等を用いることができる。これらは、単独または2種類以上を混合して用いることができる。

【0017】本発明における、(C)2官能以上のアクリロイル基を含有し、炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含有する放射線硬化モノマーは、燃えやすく形成性を付与する目的として用いる。例えば、1、4ーブタジオールジ(メタ)アクリレート、1、6ーへキサジオールジ(メタ)アクリレート、1、6ーへキサジオールジ(メタ)アクリレート、1、9ーノナンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、1、10ーデカンブジオールジ(メタ)アクリレート等がある。これらは、単独もしくは2種類以上を混合して用いることができる。

【0018】本発明における、(D)1官能以上のアクリロイル基を含有し、炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含有する放射線硬化モノマーは、燃えやすく形成性を付与する目的として用いる。例えば、tーブチル(メタ)アクリレート、イソステリアル(メタ)アクリレート、イソアミル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレート、ステアリル(メタ)アクリレート等がある。これらは、単独もしくは2種類以上を混合して用いることができる。

【0019】本発明に用いる(E)2官能以上のアクリロイル基を含有する放射線硬化モノマーは、燃えやすく形成性を付与する目的として用いる。例えば、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート系、プロピレン(メタ)アクリレート系、ドリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート系、ペンタエリスリトール(メタ)アクリレート系、ジペンタエリスリトール(メタ)アクリレート系等がある。これらは、単独または2種類以上を混合して用いることができる。

【0020】また、粘度調整や光硬化状態を調節する目的で、以下のような単官能の放射線硬化モノマーを添加しても良い。具体的には、メトキシボリエチレングリコール(メタ)アクリレート、フェノキシポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、2ーメトキシエチル(メタ)アクリレート、フェノキシエチル(メタ)アクリレート、フェノキシエチル(メタ)アクリレート等のエーテル系、2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2ーヒドロキシー3ーフェノキシポロピル(メタ)アクリレート等のヒドロキシ系、その他にアミン系、ハロゲン系、シリコーン系などの(メタ)アクリレート類があげられる。これらは、単独もしくは2種類以上を混合して用いることができる。

【0021】ペーストに必要な流動性を確保するため、バインダー溶液を添加しても良い。バインダー溶液は一般にバインダー樹脂を溶剤中に溶解した溶液である。例えば、バインダー樹脂は、ニトロセルロース、アセチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース等のセルロース系高分子、天然ゴム、ポリブタジエンゴム、クロロプレンゴム、アクリルゴム、イソプレン系合成ゴム、環化ゴム等の天然高分子、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸メチル、ポリスチレン、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリアクリルコール、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアクリルニトリル、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリウレタン

等の合成高分子等がある。これらの樹脂を単独、混合ま たは共重合体として用いることができる。

【0022】溶剤としては、トルエン、キシレンテトラ リン等の炭化水素系、メタノール、エタノール等のアル コール系、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン 系、酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル系、エチレン グリコール系、ジエチレングリコール系溶剤などを用い ることができる。

【0023】その他に、添加剤としては、イソビタン脂 肪酸エステル、ベンゼンスルホン酸等の分散剤、ブチル セテアレート、ブチルベンジルフタレート、ジブチルフ タレート、ジイソデシルフタレート等の可塑剤、湿潤 剤、分散剤、重合禁止剤等を必要に応じて添加してよ 14

【0024】これらの材料をロールミル、ビーズミル、 自動乳鉢等の混合装置を用いて、ペーストに調合する。 【0025】調合したペーストを用いて、パターニング を行う。本発明の組成物は、マスク露光によるパターニ

無機粉末

ほうけい酸鉛ガラスフリット フィラー(ムライト)

黒色顔料

 Cu_2O

 $C \circ_2 O$

 Cr_2O_2

ングには適していない。そのため、紫外線をはじめとす る放射線による硬化という特性を生かしたパターン形成 が必要となる。従って、パターン形成方法としては、ス クリーン印刷、凹版や剥離フィルムを利用した転写によ る方法などがあるが、どの方法を用いてもよい。パター ン形成後、紫外線などの放射線で硬化する。次に、40 ○℃以上の高温で焼成を行うことによって、所望の形状 を持った黒色無機構造体を作製することができる。この 組成物にて作製できる構造体は、幅100μm以下の微 細でありかつ、複雑、アスペクト比が3程度の構造体の 作製も可能である。

[0026]

【実施例】以下に実施例を示す。なお、焼成前後の透過 率は分光光度計を用いて、365nmにおける透過率に おいて評価した。

【0027】<実施例1>まず、焼成用放射線硬化ペー スト組成物の組成を以下に示す。

68重量部

9重量部

2重量部

0.8重量部

0.7重量部

0.5重量部

2官能以上のアクリロイル基を含有する放射線硬化モノマー

トリメチロールプロパントリメタクリレート

1 2 重量部

1 官能以上のアクリロイル基を含有し炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含

有する放射線硬化モノマー

ステアリルアクリレート

4 重量部

光重合開始剤

ベンゾフェノン

2重量部

添加剤

5%エチルセルロース/ジエチレングリコール

モノメチルエーテルアセテート溶液 5重量部

上記の組成を、ロールミルにて十分に混練し、ペースト とした。

【0028】上記ペーストを10cm角のソーダライム ガラス基板上全面にスクリーン印刷にて10μm厚に塗 布した後、紫外線を2000mJ/cm²照射した。照 射後、ペーストは下層まで硬化していた。次に、600

M n O

℃にて焼成を行った。焼成後、割れ、はがれ等は発生し ていなかった。なお、焼成前の透過率は15%であり、 焼成後の透過率は6%であった。

【0029】<実施例2>まず、焼成用放射線硬化ペー スト組成物の組成を以下に示す。

無機粉末

ほうけい酸鉛ガラスフリットガラスフリット 69重量部 $\mathcal{D}_{\mathcal{I}} = \mathcal{D}_{\mathcal{I}} = \mathcal{D}_{\mathcal{I}} = \mathcal{D}_{\mathcal{I}}$ 9重量部 黒色顔料 2重量部 Cr_2O_3 0.7重量部 $C \circ O$ 0.6重量部 0.6重量部 Fe_2O_3 0.2重量部

2官能以上のアクリロイル基を含有し、炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を

含有する放射線硬化モノマー

1,9-ノナンジオールメタクリレート 10重量部

単官能の放射線硬化モノマー

2-メトキシエチルアクリレート 3重量部

光重合開始剤

ベンゾフェノン 1 重量部

添加剤

フタル酸ジフェニル

1重量部

5%エチルセルロース/ジエチレングリコール

モノメチルエーテルアセテート溶液 3重量部

上記の組成を、ロールミルにて十分に混練し、ペースト とした。

【0030】このようにして得られたペーストを実施例 1と同様に10cm角のソーダライムガラス基板上全面 にスクリーン印刷にて100μm厚に塗布した後、紫外 線を2000mJ/cm²照射した。照射後ペーストは 十分硬化していた。次に、形成したパターンを600℃ で焼成を行って、パターンを形成した。焼成したパター ンは、割れ、剥がれ等が無く、また短絡も発生していな かった。なお、焼成前の透過率は2%であり、焼成後の 透過率は0.5%であった。

【0031】<実施例3>まず、焼成用放射線硬化ペー スト組成物の組成を以下に示す。

無機粉末

ほうけい酸鉛ガラスフリット

黒色顔料

 Fe_2O_3

 Cu_2O

 Cr_2O_3

 $779-(A1_2O_3)$

65重量部

1 重量部

0.3重量部

0.4重量部

0.3重量部

8重量部

2官能以上のアクリロイル基を含有する放射線硬化モノマー

エチレンオキサイド付加トリメチロール

プロパントリアクリレート(n=10) 11重量部

単官能の放射線硬化モノマー

メトキシポリエチレングリコールメタアクリレート(n=10)

6重量部

1官能以上のアクリロイル基を含有し炭素数4以上の鎖式飽和炭化水素構造を含

有する放射線硬化モノマー

ラウリルアクリレート

4 重量部

光重合開始剤

ベンゾフェノン

3重量部

添加剤

フタル酸ジフェニル

2重量部

上記組成を、ロールミルにて混練し、ペーストとした。 れ、剥がれが発生しなかった。なお、焼成前の透過率は 【0032】このようにして得られたペーストを、格子 1.8%であり、焼成後の透過率は0.4%であった。 【0033】 <比較例1>実施例3記述の無機粉末にお いて、黒色顔料として紫外線透過率の低いCuOを同量 添加した。このペーストを実施例3と同様にパターン形 成を試みた。その結果、硬化が不十分であり、表層部し か硬化していなかった。この状態で焼成を行い、焼成前 後の透過率を比較した結果、ともに0.6%であり、変 化していなかった。実施例3による本発明は比較例1の 構造体に比べて、紫外線照射が1回で硬化している上 に、紫外線透過率も低くなっており、良好な結果を示し かった。次に、形成したパターンを600℃で焼成を行 た。

[0034]

形状の凹型(中50μm、高さ100μm、ピッチ18 Oμm)の金型にスクリーン印刷を用いて埋め込んだ。 このとき、凹版上に約30μmの厚さのベタ層が形成さ れた。ペーストを被覆した面から紫外線を2000mJ /cm²照射した。次に、厚さ5μmでアクリル樹脂系 接着剤を塗布したソーダライムガラス基板とペーストを 埋め込んだ金型を $1 \text{ kg f } / \text{ c m}^2$ の圧力でプレスし、 接着剤が固化した後金型を剥がした。このときペースト は十分に硬化しており、パターンが破壊されることはな

って、パターンを形成した。焼成したパターンは、割

【発明の効果】本発明の焼成用放射線硬化ペースト組成物によれば、印刷や転写法による絶縁体、誘電体などの無機構造体の形成方法において、一回の露光深度が深く

なり、アスペクト比の高い黒色構造体の形成やパターン 形成工程の短縮が可能となる。また、熱乾燥、冷却の工 程を利用することなく形成することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J011 AC04 PA07 PA15 PA16 PB08

PB22 PB25 PC08 QA03 QA04

QA07 QA12 QA13 QA23 QA24

QA37 QA46 SA01 SA02 SA04

SA12 SA14 SA16 SA21 SA22

SA31 SA34 SA51 SA54 SA62

SA64 TA03 TA06 TA09 UA01

VAO1 VAO4 WAO7 WA10

5E001 AE00 AE04 AH01 AH09 AJ02